

村田计划扩建 MLCC 工厂，台积电扩产计划稳步推进

——电子行业跟踪报告

强于大市 (维持)

2026 年 10 月 19 日

行业核心观点:

上周申万电子指数下跌 8.75%，跑输沪深 300 指数，跑赢创业板指数。AI 算力需求催化下，MLCC 龙头村田扩产计划逐步落地，印证行业高景气，亦有望拉动产业链需求；台积电三季度业绩表现较好，指引较为积极，表明半导体产业链整体维持景气上行趋势。我们认为国产算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如 PCB、存储、MLCC 等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注 PCB、MLCC、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

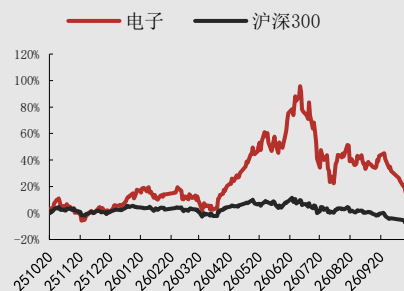
投资要点:

产业动态: (1) **MLCC**，因 AI 服务器用需求急速成长，村田制作所将扩建 MLCC 工厂，满足需求增加，且评估提前执行投资计划。村田社长中岛规巨受访表示，“正评估在熟知村田制作所生产制造方式的地区扩充产能，希望在 10 月底前敲定投资额等扩产计划细节；原先预估位于岛根县出云市的工厂产能要到 2030 年才会满载，如今却可能提前至今年就达到满载”。(2) **晶圆代工**，10 月 15 日，台积电公布截至 2026 年 9 月 30 日的第三季度财报显示，合并营收 1.49 余万亿新台币，同比增长 50.9%，环比增长 17.6%，净利润 7630.6 亿新台币，同比大增 68.7%，环比增长 8.0%，第三季度毛利率 66.4%。在产能扩张方面，台积电表示，未来几年将在中国台湾建设多座先进制程及先进封装晶圆厂，在海外建设 5 至 6 座晶圆厂。(3) **半导体设备**，在近日举行的第二十六届中国国际工业博览会上，朗道燧岩（上海）科技有限公司首次公开展示了一台极紫外（EUV）光源系统样机。该光源系统国产化率达 90%，绝大多数核心零部件为自主研发，技术路线与国际领先厂商一致，可用于芯片曝光测试。(4) **半导体设备**，美国加州时间 10 月 13 日，SEMI 发布的最新《300mm 晶圆厂展望报告》，预计 2026 年全球 300mm 前道晶圆厂设备支出将达到 1490 亿美元，同比增长 31%。预计该投资额将保持两位数增长至 2029 年，达到 2270 亿美元。全球不断有新建 300mm 晶圆厂和生产线从建设阶段稳步迈入运营阶段。若不计纯研发晶圆厂，SEMI 预测全球将在 2026 年和 2027 年分别有 20 座和 18 座新的 300mm 晶圆厂或产线开始动工建设。

行业估值: 从估值情况来看，截至 2026 年 10 月 18 日，SW 电子板块 PE (TTM) 为 54.80 倍，2019 年至 2026 年 10 月 18 日 SW 电子板块 PE (TTM) 均值为 56.91 倍，行业估值低于近年中枢水平。

风险因素: 中美科技摩擦加剧；AI 应用发展不及预期；国产技术突破不及预期；下游终端需求不及预期；市场竞争加剧。

行业相对沪深 300 指数表现



数据来源：聚源，万联证券研究所

相关研究

MLCC 龙头释放扩产信号，半导体设备零部件交期延长

MLCC 龙头停产部分料号，苹果发布首款折叠屏产品

三星电机获 MLCC 大订单，半导体设备市场规模稳步增长

分析师: 夏清莹

执业证书编号: S0270520050001

电话: (0755) 8322 3620

邮箱: xiaqy1@wlzq.com.cn

分析师: 陈达

执业证书编号: S0270524080001

电话: 13122771895

邮箱: chenda@wlzq.com.cn

正文目录

1 行业周观点.....3

2 市场行情回顾.....4

3 产业动态.....5

 3.1 MLCC：因 AI 服务器用需求增长，村田计划扩建 MLCC 工厂 5

 3.2 晶圆代工：台积电第三季度业绩表现较好，扩产计划稳步推进 5

 3.3 半导体设备：国产 EUV 光源系统样机亮相，零部件国产化率较高 6

 3.4 半导体设备：全球 300mm 晶圆厂设备支出规模有望持续增长 6

4 风险提示.....6

图表 1： 申万一级周涨跌幅（%） 4

图表 2： 申万一级年涨跌幅（%） 4

图表 3： 申万电子板块估值情况（2019 年至今） 5

1 行业周观点

AI算力需求催化下，MLCC龙头村田扩产计划逐步落地，印证行业高景气，亦有望拉动产业链需求；台积电三季度业绩表现较好，指引较为积极，表明半导体产业链整体维持景气上行趋势。我们认为国产算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储、MLCC等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、MLCC、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

中长期视角，我们建议把握AI高景气产业周期和国产突破与扩产带来的投资机遇。AI浪潮持续推进，算力建设方兴未艾，算力关键硬件环节需求旺盛，存储、PCB、MLCC等正处于景气扩张周期；此外，国产厂商先进技术创新突破，为AI芯片、先进封装优质厂商带来发展机遇，同时成熟领域产能扩充，有望提振上游半导体设备及材料等环节需求，带来投资机遇。

1) PCB，AI PCB行业受益于全球算力建设需求，高多层板及HDI市场需求增速相对较快，高端PCB扩产有望提振上游设备及材料需求，材料方面覆铜板供不应求推动产品涨价，设备方面曝光设备及钻孔设备等细分领域增速更高。建议关注在HDI、多层板等高端PCB领域前瞻布局的PCB龙头厂商，同时主流PCB厂商加速扩产，有望拉动上游设备及材料需求，建议关注覆铜板材料、钻孔及曝光设备等领域的龙头厂商。

2) 存储，受益于AI算力建设，存储供应持续偏紧，我国存储龙头厂商积极把握行业发展机遇，市场份额跻身前列。建议关注DRAM及NAND Flash领域国产龙头厂商市场份额提升带来的投资机遇。

3) MLCC，AI算力、新能源车等需求驱动高端MLCC需求快速增长，市场规模稳步提升，全球龙头厂商已调涨AI及车规产品价格，行业整体有望步入景气周期。建议关注前瞻布局高端MLCC产品的国产龙头厂商，在行业景气回升时有望具备较强盈利修复弹性。

4) 先进封装，华为发布“韬定律”，通过逻辑折叠等技术创新推动芯片性能提升，先进封装是实践的重要技术环节之一，市场规模稳步增长，且全球芯片大厂积极布局该领域。建议关注在先进封装各前沿技术领域前瞻布局的优质厂商，如在混合键合技术、玻璃基板材料、光互连封装、Chiplet技术等领域取得突破的龙头厂商。

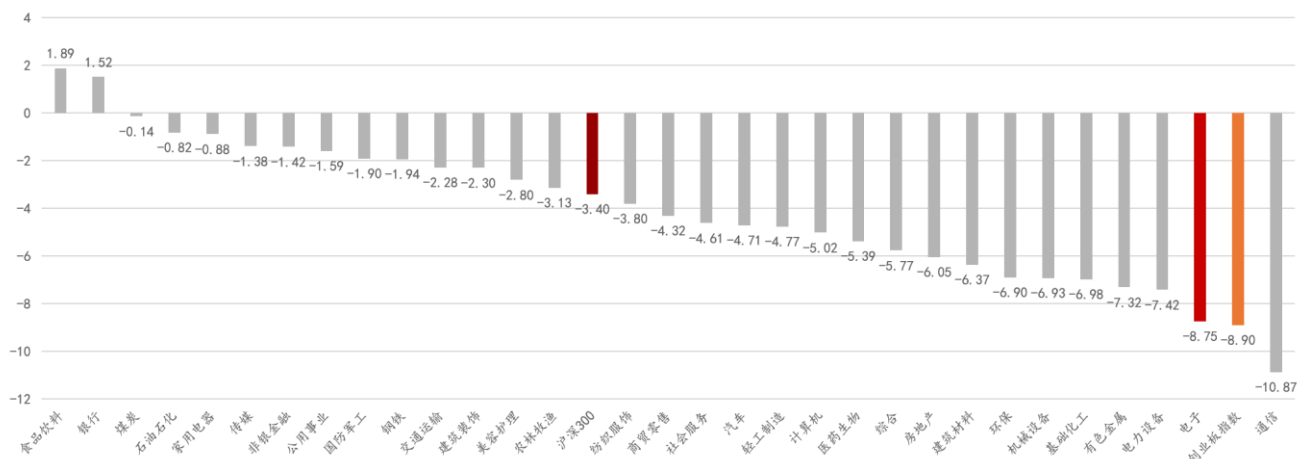
5) AI芯片，国产AI芯片市场份额快速提升，由国产芯片、国产框架、国产大模型构成的完整AI生态闭环正加速形成。建议关注AI芯片领域技术创新突破并取得下游客户认可的国产优质厂商，在国产算力加速建设背景下产品出货需求旺盛有望带来投资机遇。

6) 半导体设备及材料，半导体各行业优质公司积极筹备上市，存储芯片龙头公司业绩亮眼，国内晶圆厂加速推动产能扩充建设，有望提振上游半导体设备、零部件及材料需求，同时部分环节仍有较大国产替代空间。建议关注半导体设备、零部件及材料领域的优质龙头厂商，受益于下游扩产及国产替代双重增长动力，产品出货需求旺盛有望带来投资机遇。

2 市场行情回顾

上周，申万电子行业跑输沪深300指数，跑赢创业板指数。上周申万电子指数下跌8.75%，在31个申万一级行业中排第30，沪深300指数下跌3.40%，创业板指数下跌8.90%，申万电子跑输沪深300指数5.35个百分点，跑赢创业板指数0.16个百分点。

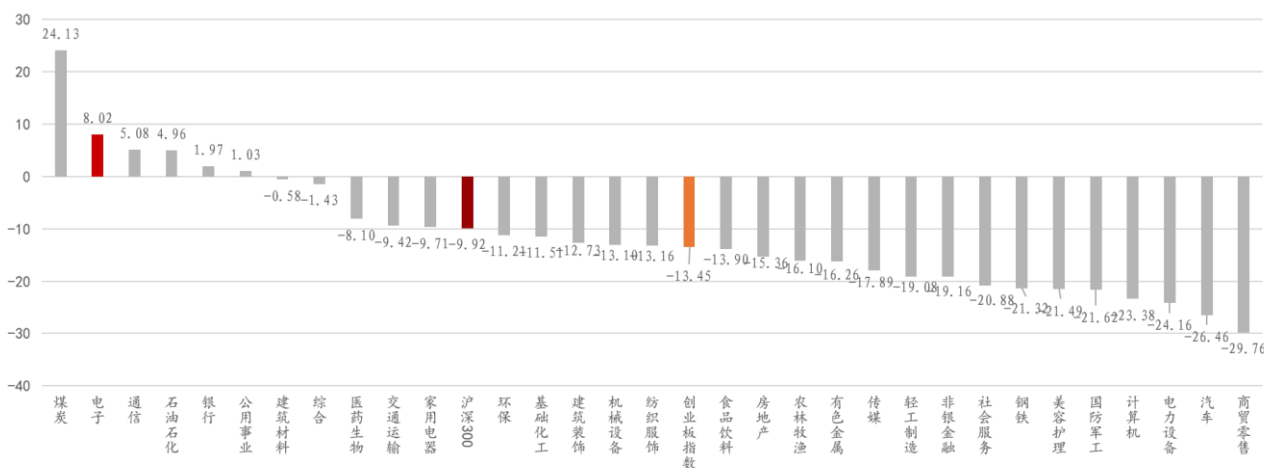
图表1：申万一级周涨跌幅（%）



资料来源：iFinD，万联证券研究所

2026年初以来，申万电子行业跑赢沪深300指数和创业板指数。2026年初至2026年10月18日，沪深300指数下跌9.92%，创业板指数下跌13.45%，申万电子行业上涨8.02%，在31个申万一级行业中排名第2位，跑赢沪深300指数17.94个百分点，跑赢创业板指数21.46个百分点。

图表2：申万一级年涨跌幅（%）



资料来源：iFinD，万联证券研究所

申万电子行业估值略低于近年。从估值情况来看，截至2026年10月18日，SW电子板块PE (TTM) 为54.80倍，2019年至2026年10月18日SW电子板块PE (TTM) 均值为56.91倍，行业估值低于近年中枢水平。基于AI算力加速建设、半导体产业链景气上行等趋势利好，我们认为板块估值仍有上行空间。

图表3: 申万电子板块估值情况 (2019 年至今)



资料来源: iFinD, 万联证券研究所

3 产业动态

3.1 MLCC: 因 AI 服务器用需求增长, 村田计划扩建 MLCC 工厂

据满天芯援引日经新闻报导, 因AI服务器用需求急速成长, 村田制作所将扩建MLCC工厂, 满足需求增加, 且评估提前执行投资计划。村田社长中岛规巨受访表示, “正评估在熟知村田制作所生产制造方式的地区扩充产能, 希望在10月底前敲定投资额等扩产计划细节; 原先预估位于岛根县出云市的工厂产能要到2030年才会满载, 如今却可能提前至今年就达到满载”。目前村田正与生产设备业者等进行协商, 且正评估取得所需的厂房。村田此前宣布, 计划在截至2027年度为止的2年期间, 对MLCC生产设备投资约800亿日元。MLCC的原材料也进入扩产阶段。村田制作所旗下子公司冈山村田制作所计划投资约90亿日元, 新增产线扩产MLCC等电子零件用陶瓷原料。新产线将在2026年10月动工, 2028年4月投产, 本次扩产新增产能规模暂未披露。需求持续高增长下, 其它日韩MLCC厂商也开始考虑加快扩产步伐。三星电机计划在菲律宾工厂扩产服务器MLCC产能, 以应对爆发式需求; 京瓷7月份宣布7年内投资1000亿日元扩产AI服务器MLCC产能; 太阳诱电计划将MLCC年产能增速由原定的10%提升至15%。(来源: 满天芯)

3.2 晶圆代工: 台积电第三季度业绩表现较好, 扩产计划稳步推进

10月15日, 台积电公布截至2026年9月30日的第三季度财报显示, 合并营收1.49余万新台币, 同比增长50.9%, 环比增长17.6%, 净利润7630.6亿新台币, 同比大增68.7%, 环比增长8.0%, 市场预估7394.9亿新台币。第三季度毛利率66.4%, 市场预估66.5%。台积电表示, 2纳米制程出货占公司2026年第三季晶圆销售金额的8%; 3纳米制程出货占全季晶圆销售金额的33%, 5纳米制程出货占全季晶圆销售金额的28%; 7纳米制程出货则占全季晶圆销售金额的10%。总体而言, 先进制程(定义为7纳米及更先进制程)的营收达到全季晶圆销售金额的10%。业绩指引方面, 台积电预计第四季度销售额在523亿至543亿美元, 市场预估503.5亿美元。台积电确认2026年资本支出预期维持在600亿至640亿美元。

在产能扩张方面, 台积电表示, 未来几年将在中国台湾建设多座先进制程及先进封装

晶圆厂,在海外建设5至6座晶圆厂。N2制程已于2025年第四季度实现量产且良率良好,目前正在新竹与高雄两地分多期顺利爬坡,预计2027年N2家族技术的年产能将翻倍以上。A14制程规模量产计划于2028年启动。台积电表示,中国台湾科学园区的新3纳米厂规模量产稳步推进,计划于2027年上半年投产,并将在台南新增一座3纳米晶圆厂,计划于2028年上半年实现规模量产。亚利桑那州第二期厂房建设已经完工,正在进行设备搬入与安装,规模量产将于2027年第三季度启动。在日本,第二座厂导入3纳米的计划推进顺利,计划于2028年实现规模量产。除全部新建厂房外,台积电在台湾地区持续将5纳米设备转产支持3纳米。此外,台积电正考虑在亚利桑那州以外的地区扩大美国产能,正在对得克萨斯州进行选址评估。(来源:SEMI)

3.3 半导体设备: 国产 EUV 光源系统样机亮相, 零部件国产化率较高

在近日举行的第二十六届中国国际工业博览会上,朗道燧岩(上海)科技有限公司(简称“朗道燧岩”)首次公开展示了一台极紫外(EUV)光源系统样机。该光源系统国产化率达90%,绝大多数核心零部件为自主研发,技术路线与国际领先厂商一致,可用于芯片曝光测试。7nm及以下先进制程芯片制造需要依赖EUV光刻机,而EUV光源则是EUV光刻机的三大核心零部件之一。长期以来,受海外技术垄断与禁运限制影响,EUV光刻机及核心的EUV光源是制约中国高端芯片自主可控的关键环节。朗道燧岩此次展出的光源样机,标志着国产EUV光源从实验室走向产业化的关键一步。根据朗道燧岩官网公布的技术参数显示,其低功率EUV光源系统FlintNano LPP-OXX0的驱动激光功率为1000W,激光频率1至20kHz,转换效率大于2%,亮度达100W/mm²sr,EUV能量大于15W,持续工作时间超过100小时。该系统等离子体尺寸为60μm,等离子体稳定性为3% RMS,能量稳定性为5%。

据工作人员受访表示,该光源系统距离量产仍需3至5年时间。当前面临的核心挑战在于提升输出功率和长期运行稳定性。商用EUV光刻系统要求光源功率达到数百瓦级别,并能在长时间运行中保持高度可靠。比如,ASML的EUV光源系统自2018年推出250W版本以来,已实现批量生产应用,目前正在向更高的1000W功率等级演进。朗道燧岩于工博会现场展示的样机目前验证了技术路线的可行性,但距离工业级应用所需的产品成熟度仍有明显差距。从15W级别的EUV能量输出到数百瓦量级的量产要求,朗道燧岩需要跨越的不仅是功率的倍数级提升,更包括等离子体稳定性、光源寿命和系统集成可靠性的全面突破。(来源:芯智讯)

3.4 半导体设备: 全球 300mm 晶圆厂设备支出规模有望持续增长

美国加州时间10月13日,SEMI发布的最新《300mm晶圆厂展望报告》,预计2026年全球300mm前道晶圆厂设备支出将达到1490亿美元,同比增长31%。预计该投资额将保持两位数增长至2029年,达到2270亿美元。全球不断有新建300mm晶圆厂和生产线从建设阶段稳步迈入运营阶段。若不计纯研发晶圆厂,SEMI预测全球将在2026年和2027年分别有20座和18座新的300mm晶圆厂或产线开始动工建设。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示:“半导体需求的增长正日益转化为全球半导体产业的实际制造产能扩张,设备投资在增强,这种扩张将为支持人工智能、高性能计算以及广泛的下一代半导体应用提供坚实的制造基础。”(来源:SEMI)

4 风险提示

中美科技摩擦加剧;AI应用发展不及预期;国产技术突破不及预期;下游终端需求不及预期;市场竞争加剧。

行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上；

同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间；

弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。

公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；

增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；

观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；

卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

基准指数：沪深300指数

风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息撰写，本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性，也不保证文中的观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。分析师任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。未经我方许可而引用、刊发或转载的引起法律后果和造成我公司经济损失的概由对方承担，我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所

上海浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦

北京西城区平安里西大街 28 号中海国际中心

深圳福田区深南大道 2007 号金地中心

广州天河区珠江东路 11 号高德置地广场